



# 2016 中国硬件创新大赛

北京 上海 深圳 杭州 武汉 广州



鸣谢



By 曾海银 华强聚丰 COO



微信扫一扫  
关注电子发烧友



HICC

2016 中国硬件创新大赛

## 华强聚丰

通过整合电子工程师社群资源促进交易

# 一站式供应链助力中国硬件创新

### Index

1. 分享：供应链看市场
2. 我们为什么举办硬件创新大赛？
3. 第1届大赛回顾
4. 华强聚丰是谁？



# 供应链看市场

## 中国 大市场 5 大IoT应用

- 1.家居管理（Home Security）
- 2.智能家电（Home Appliance）
- 3.机器人（Robot）
- 4.运动/健康（Sports/Fitness）
- 5.无人机（Drone）

**HICC****2016 中国硬件创新大赛**

## 1.家居管理 ( Home Security ) - TAM

### 家居管理 ( Home Security ) 2016 年 TAM 预估 :

N o.	Function	Brand	Ref. price(\$)	Quantity (PCS/Y)	TAM (\$/Y)	Remark
1	WIFI /WIFI Module	庆科/汉枫/古北/ 江波龙/安信可/乐鑫	3	2M	6M	BCM/MTK/QCM /RTK/TI/乐鑫等 IC
2	BLE	Nordic/TI/Dialog /NXP/Cypress/CSR	1	2M	2M	
3	ZigBee	TI/NXP/Ember /Atmel	1.5	7M	10.5M	
4	Sub-1GHz /Z-WAVE	TI/Silicon Lab /Sigma Designs	0.5	9M	4.5M	
5	MCU	Atmel/ST/TI /Freescale	1	2M	2M	门锁
5	CPU	海思/安霸	4	3M	12M	IP Camera
Total			11	25M	<b>37M</b>	

**HICC****2016 中国硬件创新大赛**

## 2. 智能家电 ( Home Appliance ) - TAM

### 家电市场 2016 年 TAM 预估 :

N o.	Function	Brand	Ref. price(\$)	Quantity (PCS/Y)	TAM (\$/Y)	Remark
1	MCU, Touch (8/16 bit )	NXP,MHCP,ATMEL,R enese,国内品牌	0.6	450M	270M	部分含 Touch 功能
2	MCU, Touch (32 bit,M0+,M3)	NXP,MHCP,ATMEL, TI, Renese,ST, 国内品牌	1.0	50M	50M	部分含 Touch 功能
3	WiFi Module	庆科/汉枫/古北/ 江波龙/安信可	2.5	50M	125M	BCM/MTK/QCM /RTK/TI/乐鑫等 IC
4	语音 IC	Nuvoton/Holtek	0.4	10M	4M	
5	Power (AC-DC, DC-DC, LDO)	TI/ON/Fairchild/Int ersil/MPS/国内品牌	0.5	500M	250M	
Total			4.0~4.5	500M	<b>699M</b>	

预估 2016 年家电市场 MCU TAM 约 500M，其中 WiFi 装机量达 **50M 台**。  
2015 年冰箱 ( 90M ) + 空调 ( 155M ) + 洗衣机 ( 70M ) total 出货达 315M 台

**HICC****2016 中国硬件创新大赛**

### 3.运动/健康 ( Sports/Fitness ) - TAM

#### 运动/健康市场 2016 年 TAM 预估：

No.	Function	Brand	Ref. price	Quantity (PCS/Y)	TAM(\$K/Y)	Remark
1	MCU	ST/NXP/Microchip	1	1M	1M	
2	BLE	Nordic/TI/CSR	1	2M	2M	
3	Sensor	Invensense/ ST/Freescale	0.5~3	4M	8M	
4	WIFI	庆科/汉枫/古北/乐鑫	3	200K	0.6M	
5	Power (Charger/DC-DC)	TI/ON/Intersil/MPS	1~2	2M	3M	
TOTAL			6.5~10	2M	<b>15M</b>	

运动/健康市场属于市场推广阶段，接下来健康类的产品会有大的增长，2017 年市场的总量预估 10M 台。



HICC

2016 中国硬件创新大赛

## 4.服务机器人 ( Service Robot ) - TAM

### 服务机器人市场 2016 年 TAM 预估：

No.	Function	Brand	Ref. price	Quantity (PCS/Y)	TAM(\$K/Y)	Remark
1	CPU	Rockchip/AllWinner/intel/MTK	5 ~ 14	150K	1.5M	
2	语音识别模组	科大讯飞/思必驰/云知声	15	150K	2.25M	
3	Sensor	Invensense/ ST/Freescale/奥比中光	2~15	150K	1.5M	
4	Audio Codec	RealTek/Nuvoton/顺芯/Wolfson	0.5	150K	0.75M	
5	Flash & DDR	Mircon/Toshiba/Nanya/Sandisk	5	300K	1.5M	
6	MCU	ST/NXP/Nuvoton	1	350K	0.35M	
7	Motor Driver	Allegro/TI /Toshiba	0.5	700K	0.35M	
8	Power (Charger/DC-DC)	TI/ON/NXP	2	350K	0.7M	
TOTAL			31 ~ 53	350K	9M	

服务机器人市场 2016 年在蛰伏期，2017 年进入增长期，市场总量预估：1.1M 台

**HICC****2016 中国硬件创新大赛**

## 5.无人机 ( Drone ) - TAM

### 无人机市场 2016 & 2017 年 TAM 预估 :

No.	Function	Brand	Ref. price(\$)	Quantity (PCS/Y)	TAM (\$/Y)	Remark
1	MCU(M3/M4)	NXP, ATMEL,ST	1.5	6.1M	9.15M	
2	DSP	TI	3	0.5M	3M	
3	Remote TX+RX	ADI/TI/Silicon Lab.	2	6.1M	12.2M	
4	FPGA+4G RF	Xilinx/Intel(Altera)	10	1.1M	11M	
5	MPU+WIFI RF	Qualcomm/Intel/RK	8	5M	40M	
6	Memory	Micron/Samsung/TS B	5	6.1M	30.5M	
7	Sensor(g, gyro., )	ST/BOSCH/Invensense/	2.5	6.1M	15.25M	
8	GPS	CSR/UBLOX/QCM	2	5M	10M	
9	CMOS Sensor	OV/Sony/Samsung	3	6.1M	18.3M	
10	Power(Charger, DC-DC, LDO)	TI/Intersil/国内品牌	0.5	6.1M	3.05M	
Total			26.5~28	6.1M	<b>162M</b>	



HICC

2016 中国硬件创新大赛

# 我们为什么 举办硬件创新大赛？

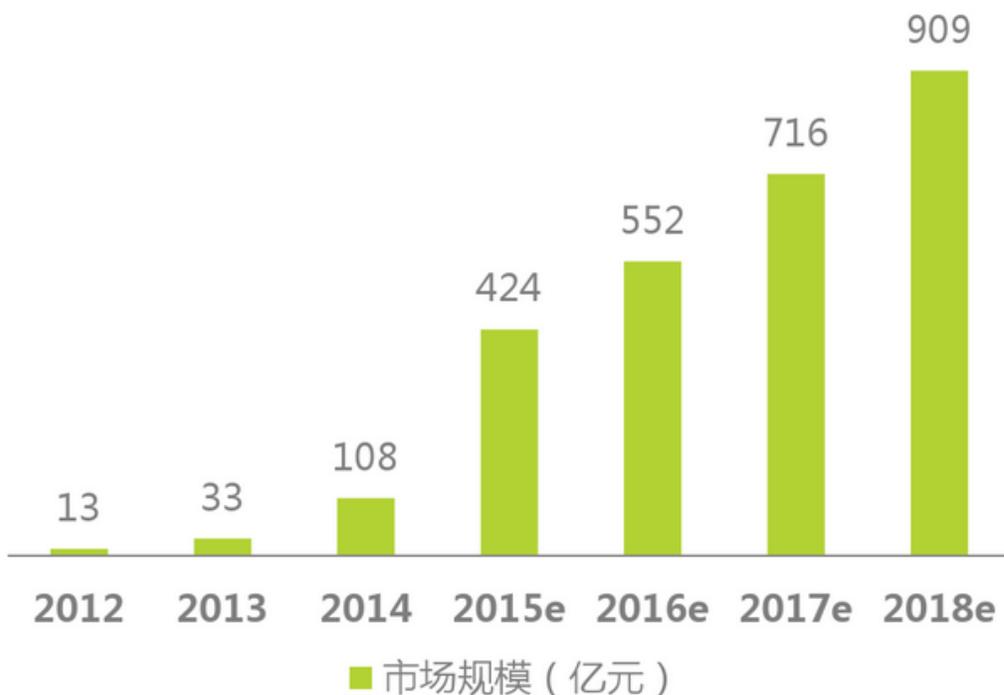


HICC

2016 中国硬件创新大赛

# 现状与趋势

## 2012-2018年中国智能硬件市场 规模



Data from 艾瑞咨询

PEST：大环境有利于智能硬件发展，但过程曲折

**政策：整体支持行业发展**

- 政府发力支持、标准正在完善
- 政策上目前还缺乏统一管理

**经济：智能硬件投资回归理性**

- 国民经济增速持续放缓
- 资本市场阶段性调整，投资更加谨慎

**社会：生活趋向互联网化、智能化**

- 实物消费向服务型消费转移
- 生活方式互联网化、智能化、消费方式多样化

**技术：日渐成熟，诸多领域仍需突破**

- 技术日渐成熟，为智能硬件发展提供了条件
- 电池、人工智能等多种技术还需突破



HICC

2016 中国硬件创新大赛

## 智能硬件有哪些坑？

28%

- 产品定义、没有销量
- 软件功能无法实现
- 无法低成本获取用户
- UI/UE导致失败



72%

- 缺少硬件合伙人导致失败
- 芯片选型错误
- 方案错误，导致不能量产
- 制造环节出问题
- 交期一拖再拖
- 良率极低
- 设计与实物差别巨大
- 资金备货出现问题
- 强制认证不能通过，产品无法上市



HICC

2016 中国硬件创新大赛

# 智能硬件创业？ 中国硬件大赛平台生态资源

技术

电子发烧友

- 200万电子工程师
- 100家IDH
- 1000个方案
- 30家顶级原厂

资金

200+投资机构

- 极星资本
- 聚丰投资
- 联想之星
- .....

供应链

一站式供应链

- 华强聚丰供应链
- 华强PCB
- 华强芯城
- 星云供应链
- .....

市场与  
销售

聚丰硬件

- 深度联盟互联网平台
- 社群电商
- 七丽女性网
- 亲亲宝贝网
- 乐哈健康保健网
- PC6 下载网
- 跑跑车游戏网
- .....



中国国际高新技术成果交易会  
CHINA HI-TECH FAIR



中国创新创业大赛  
China Innovation & Entrepreneurship Competition

国家级活动

- 1, - 对接国赛
- 2, - 高交会重要活动

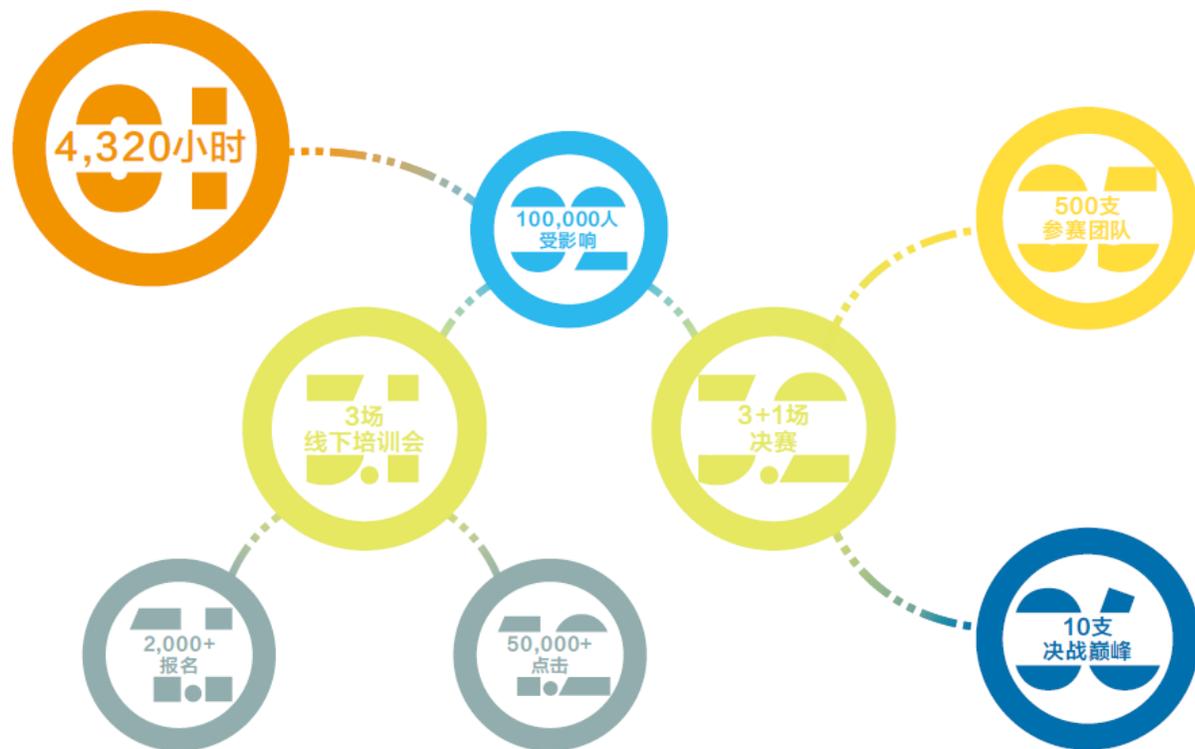
# 第1届大赛回顾



HICC

2016 中国硬件创新大赛

## 2015中国硬件大赛回顾



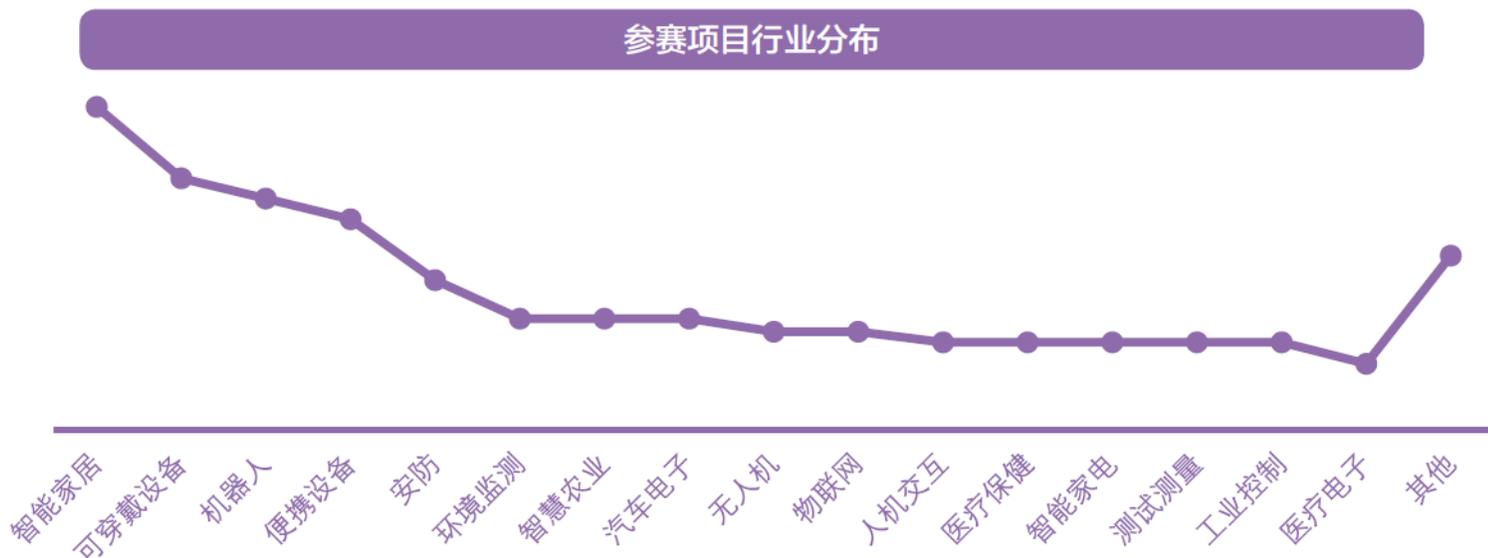
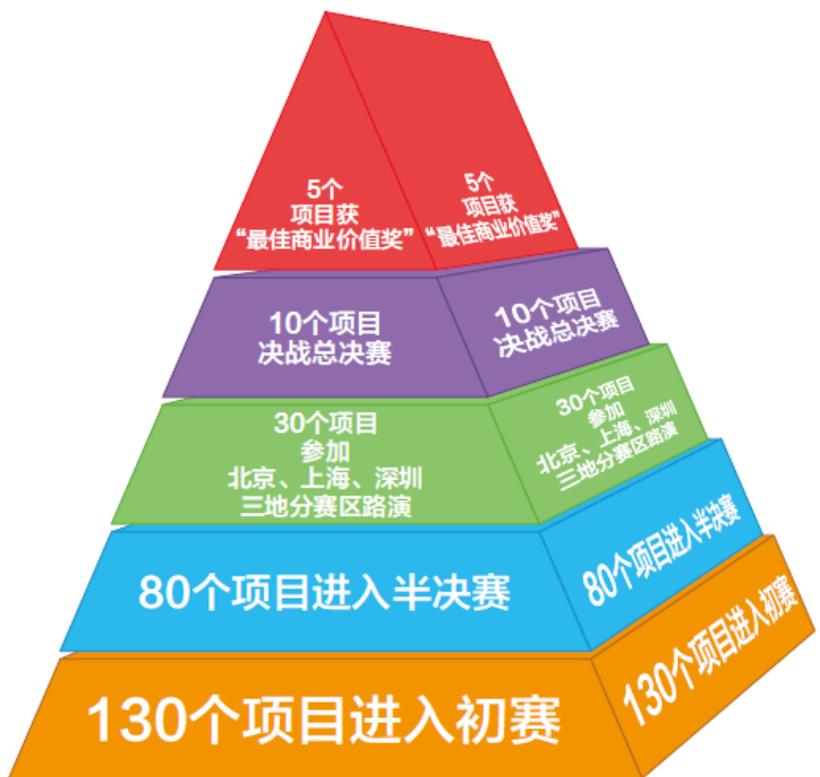
1. 超过100,000工程师及创客小伙伴收获大赛详细情况;
2. 超过2,000名硬创先锋报名参加线下培训交流会;
3. 500支硬创团队激烈角逐;
4. 超过2,000名听众报名决赛现场活动



HICC

2016 中国硬件创新大赛

## 2015中国硬件大赛回顾





HICC

2016 中国硬件创新大赛

## 2015中国硬件大赛回顾

“最佳商业价值奖” 项目介绍

# 总值：1.6亿

### 儿童智能内衣

置各种传感器的内衣，监控婴儿的被窝温度、睡眠质量、还能够在婴儿踢被子的时候提醒。

### WIFI云门铃

访客在按门铃的时候，云门铃会启动拍照，并快速把来访者的照片拍下来穿给用户，确认访客；识别并自动抓拍走过的人。

### 机器人仿生手

五个自由度，可以实现人手的功能；人手仿真皮肤，触觉反馈系统；多功能控制运用；三万左右的售价。

### 针对户外的智能信标

一款借助蓝牙BLE与智能手机连接的便携式通信设备。可以通过其配套的APP用于与组队的成员进行短距离通信和相互gps位置分享，解决了户外给队友位置分享和通信的难题。

### 骑行宝

一款智能骑行社交软件，利用物联网技术使骑行软件与智能把立相结合，将传统自行车升格为智能自行车，让骑友、自行车、服务商互联在一起，实现人车互联、专业性、娱乐性。



HICC

2016 中国硬件创新大赛

**华强聚丰是谁？**



HICC

2016 中国硬件创新大赛

## 华强聚丰

通过整合电子工程师社群资源促进交易

### 以电子工程师为中心的商业生态

它了解工程师洞察工程师并满足工程师，它恰恰表达的是工程师设计，采购，工作和学习方式的改变。

我们正在做这事，但仅仅只是开始！



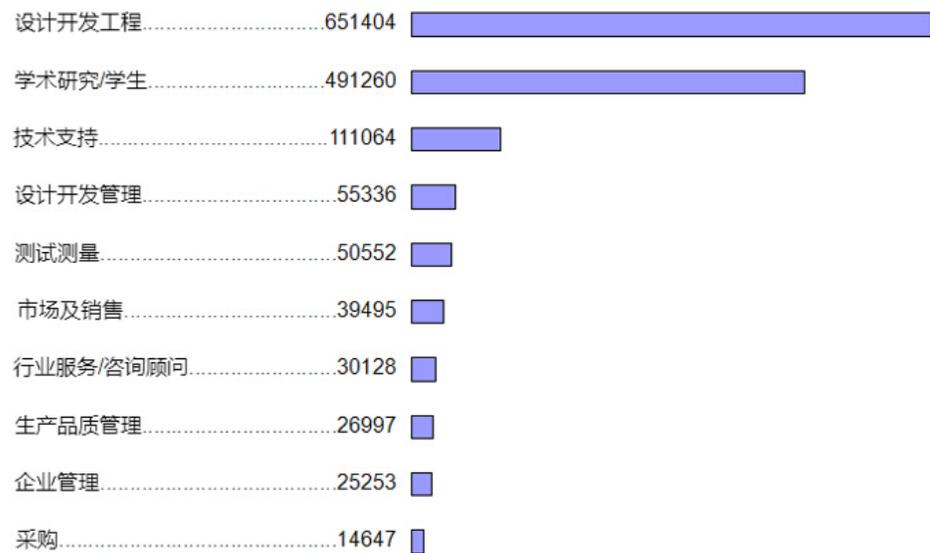
HICC

2016 中国硬件创新大赛



## 200+万电子行业注册客户

我们为多个细分行业提供服务—注册用户达200+万



月均浏览量

**6,172,354**



月均独立访客数

**2,102,478**



30天活跃用户数

**1,279,931**



月均会话数

**2,738,114**



HICC

2016 中国硬件创新大赛

# 华强聚丰

通过整合电子工程师社群资源促进交易

## 我们的业务

电子发  
发烧友



媒体&工程师社区

华强  
PCB



多层板定制商城

华强  
芯城



电子元器件商城

聚丰  
硬件



让硬件创业更简单

聚丰  
供应链

聚丰供应链

供应链/SMT



HICC

2016 中国硬件创新大赛



24场线下技术论坛覆盖所有热门技术领域



线下论坛

- 电子工程师节
- 中国IOT大会

工程师对工程师的在线互动平台，解决您的技术问题，同时拓展您的人脉



在线教育  
在线研讨会



原厂最先进的技术在线培训

E2E 社区

开发平台社区  
评测试用

设计资源



从专业角度为工程师提供实用设计，解决方案，Datasheet及应用指南

智能硬件 创业平台  
-中国硬件创新大赛  
- Demo Show



聚丰硬件

工程师众筹



工程师的众筹平台

The End



**曾海银 Ben Tseng**

华强聚丰 COO

eMail: [zenghaiyin@elecfans.com](mailto:zenghaiyin@elecfans.com)

Tel: 13380351156